



各 位

平成 23 年 11 月 24 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 風 間 悦 男  
(コード番号 6855 東証 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝  
電 話 0 6 ( 6 4 8 2 ) 2 0 0 7

### 平成 23 年度近畿地方発明表彰 地域協会会長賞受賞のお知らせ

当社はこの度、平成 23 年度近畿地方発明表彰式にて地域協会会長賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

当社が保有するプローブカードの熱膨張対策に関する基本特許が、技術的に優秀且つ実施効果の高い特許であると評価され、11月21日、平成23年度近畿地方発明表彰式にて、地域協会会長賞を受賞しました。

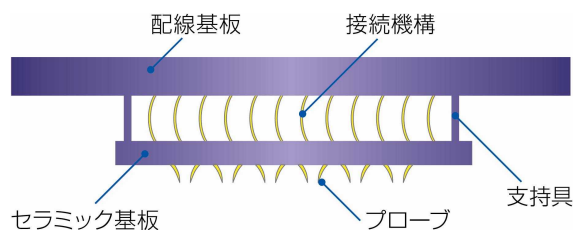
地方発明表彰は、社団法人発明協会の主催により、大正10年よりはじまった顕彰です。「その発明が地域産業にいかに関与しているのか」という観点から全国を8地方に分け、それぞれの地方から生まれた優れた技術を顕彰するものです。

当社は、半導体産業に一層の貢献を図るように、今後も新たな技術開発に努めます。

#### < 特許内容 >

本特許は、高温下で半導体を検査するプローブカードの熱膨張対策として、シリコンウエハーと同程度の熱膨張率のセラミック基板にプローブを取り付け、このセラミック基板を、配線パターンが形成された配線基板に隙間を設けて取り付ける構造を提案するものです。特に最近の高精度のプローブカードには、不可欠な技術となっております。

この構造は、当社が国内において1997年に第2632136号として特許取得し米国、ドイツ、韓国、台湾においても認められております。



以上